

当下，晶圆代工厂成了香饽饽。近日，集邦咨询旗下拓璞产业研究院公布了2020年第二季度全球前十大晶圆代工厂营收排名。其中，台积电稳居第一，中芯国际排名第五。报告显示，今年第二季度，台积电营收高达101亿美元，较去年同期大涨30.4%。三星排名第二，营收36.78亿美元，同比增长15.7%；格芯(GlobalFoundries)位列第三，营收14.52美元，同比增长6.9%。

此外，联电、中芯国际、高塔半导体、力积电、世界先进、华虹半导体、东部高科跻身前十。以下为具体排名：

表、2020年第二季全球前十大晶圆代工厂营收排名 (单位：百万美元)

排名	公司	2Q20E	2Q19	YoY	M/S
1	台积电(TSMC)	10,105	7,750	30.4%	51.5%
2	三星(Samsung)	3,678	3,180	15.7%	18.8%
3	格芯(GlobalFoundries)	1,452	1,358	6.9%	7.4%
4	联电(UMC)	1,440	1,162	23.9%	7.3%
5	中芯国际(SMIC)	941	791	19%	4.8%
6	高塔半导体(TowerJazz)	310	306	1.3%	1.6%
7	力积电(PSMC)	298	174	71%	1.5%
8	世界先进(VIS)	265	223	18.9%	1.4%
9	华虹半导体(Hua Hong)	220	230	-4.4%	1.1%
10	东部高科(DB HiTek)	193	185	4.6%	1%
前十大合计		18,903	15,359	23.1%	96.4%

注：
(1)三星计入System LSI及晶圆代工事业部之营收
(2)格芯计入IBM业务收入
(3)力积电仅计入晶圆代工营收
(4)华虹半导体仅计算财报公开数字
数据来源：各厂商，拓璞产业研究院整理，2020/06

报告称，台积电受惠5G手机AP、HPC和远程办公教学的CPU/GPU需求推升先进制程营收表现，加上成熟制程产品需求稳定，预估第二季营收年成长超过30%。

针对华为禁令的影响，考量其他客户包括AMD、联发科、英伟达、高通等订单已有规划，应能减少稼动率下滑幅度(ps.指一台机器设备实际的生产数量与可能的生产数量的比值)。

三星则受惠高通7系列中高端5G芯片客户采用率良好，7nm的需求状况保持稳定，CIS(CMOS影像感测器)、DDIC(显示器驱动IC)等则预期5G手机渗透率增加而扩大供给。另外扩充EUV生产线，拓展移动业务以外的应用，预估第二季营收年成长达15.7%。

报告提到，中芯国际的NOR Flash、eNVM等12寸晶圆，以及PMIC(电源管理IC)指纹识别芯片与部分通用MCU等8寸晶圆需求支撑营收表现，预估第二季年成长达19%。然而华为禁令可能带来不确定性，恐影响稼动率表现。

自 快科技